

|| 企業調査レポート ||

## フェローテック

6890 東証スタンダード市場

[企業情報はこちら >>>](#)

2026年7月7日 (火)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

## 目次

■ 要約	01
1. 2026年3月期の業績概要	01
2. 2026年12月期の業績見通し	01
3. 中期経営計画	02
■ 会社概要	03
1. 会社概要	03
2. 沿革	03
■ 事業概要	04
1. 事業セグメント	04
2. 半導体等装置関連事業	04
3. 電子デバイス事業	06
4. 車載関連事業	08
5. その他	08
6. 特色、強み	09
■ 業績動向	10
1. 2026年3月期の業績概要	10
2. セグメント別概況	13
3. 主な投資と減価償却費	15
■ 今後の見通し	15
1. 2026年12月期の業績見通し	15
2. サブセグメント別見通し	17
3. 投資額と減価償却費の見通し	18
■ 中長期の成長戦略	18
1. 中期経営計画の基本方針	18
2. 定量的目標 (KPI)	19
3. 主な工場新設・生産能力増強の状況	19
■ 株主還元策	20

## ■ 要約

### 2026年3月期は償却負担増を吸収し14.4%の営業増益へ。 半導体等装置関連事業と電子デバイス事業がけん引

フェローテック<6890>の主力事業は、真空シール・金属加工、石英製品、セラミックス、CVD-SiC (化学蒸着法炭化ケイ素)、磁性流体、サーモモジュール、及びパワー半導体基板など、多岐にわたる製品、装置、部品、素材等の製造・販売である。それにとどまらず、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに、各種部品等の洗浄及び受託加工・組立サービスなどの事業も幅広く展開している。

#### 1. 2026年3月期の業績概要

2026年3月期の業績は、売上高が前期比5.3%増の288,933百万円、営業利益が同14.4%増の27,561百万円、経常利益が同2.0%増の26,063百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同5.1%減の14,886百万円となった。主力の半導体等装置関連事業は、主要顧客からの需要増に支えられて増収増益となった。電子デバイス事業も光トランシーバ向けサーモモジュールが堅調に推移したことで増収増益となったが、車載関連事業はEV向け等のパワー半導体基板及びサーモモジュールが低迷し、微減収及び減益となった。セグメント別の売上高は、半導体等装置関連事業が同12.0%増、電子デバイス事業が同14.1%増、車載関連事業が同4.0%減、その他事業が同39.8%減となった。利益面においては、営業外費用で支払利息の増加や為替差損の計上があったことから、経常利益は同2.0%増に止まった。また、法人税等が増加したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益は減益となった。なお、設備投資額は54,598百万円 (同51,776百万円)、減価償却費は27,426百万円 (同23,672百万円) となり、ともに高水準が続いた。

#### 2. 2026年12月期の業績見通し

2026年12月期の業績は、売上高350,000百万円 (2026年3月期比21.1%増)、営業利益38,000百万円 (同37.9%増)、経常利益36,000百万円 (同38.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益23,000百万円 (同54.5%増) を見込んでいる。生成AIやデータセンター向け需要を中心に世界的に半導体市場が活況を呈している状況で、主力の半導体等装置関連事業の売上高は同20.0%増を見込んでいる。さらにAI関連向けサーモモジュールがけん引して電子デバイス事業も同28.4%増を予想する。車載関連事業は、EV向け需要の回復に伴いパワー半導体基板やセンサが増加することから同23.6%増を予想している。その他事業も底打ちの兆候が見られることから同4.4%増を見込んでいる。その結果、増収により高水準の減価償却費を吸収する見込みであり、営業利益は大幅な増益予想となっている。設備投資額は65,000百万円 (同19.1%増)、減価償却費は32,171百万円 (同27.6%増) と増加を見込んでいる。

なお、同社は2026年12月期より決算期を3月から12月に変更した。連結子会社は従来どおり12ヶ月決算 (1～12月) のため、同社単体が9ヶ月決算 (4～12月) となることによる連結業績への影響は限定的である。

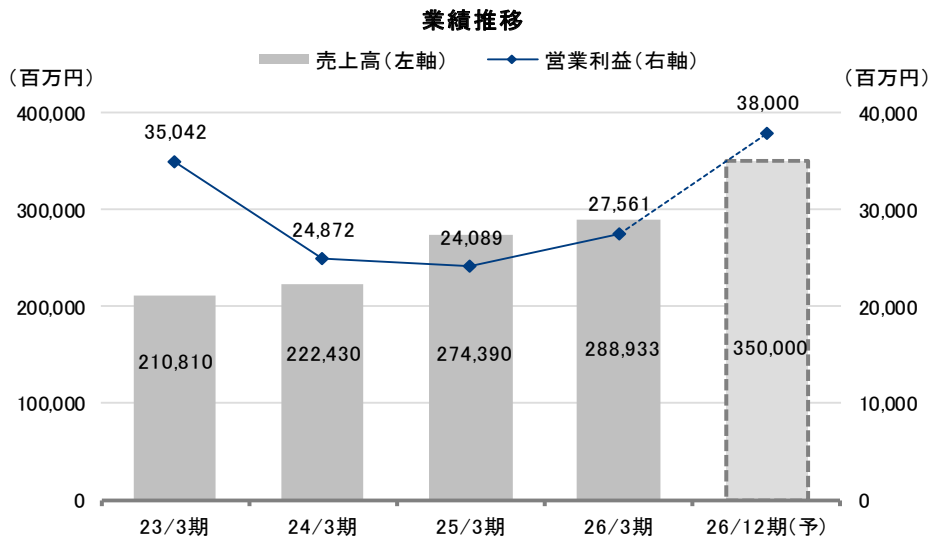
要約

3. 中期経営計画

同社は2028年12月期を最終年度とする中期経営計画を既に発表しているが、終了した2026年3月期の業績を踏まえ、この計画をロールオーバーして修正した。新たな定量的な最終目標には、2028年12月期における売上高450,000百万円、営業利益57,000百万円、営業利益率12.7%、及びROE11.0%などが掲げられている。また、この期間における設備投資総額の累計は1,600億円を計画している。引き続き成長ドライバーとして、石英製品、セラミックス、及びシリコンパーツ等の半導体材料、装置部品洗浄、石英坩堝、及び再生ウエーハ等の半導体サービス、金属加工及び蒸着装置等の半導体金属・装置、並びにサーモモジュール及びパワー半導体基板等の電子デバイスを挙げており、この方針に変更はない。非常に高い目標とも言えるが、足元の業績は好調に推移しており、同社は基本的な戦略を粛々と進めて目標達成を目指す構えである。

Key Points

- ・シリコンやセラミックス等の無機系製品の大手メーカー。主に半導体業界向けの製品を展開
- ・好調な半導体業界を背景に2026年12月期は前期比37.9%の営業増益予想
- ・中期経営計画をロールオーバーし、2028年12月期に営業利益57,000百万円を目指す



出所：決算短信よりフィスコ作成

## ■ 会社概要

### シリコン、セラミックス等無機系製品の大手メーカー

#### 1. 会社概要

同社は2026年3月末現在(有価証券報告書)では、傘下に連結子会社80社、持分法適用会社13社を擁する純粋持株会社であったが、2025年7月1日付で国内事業子会社である(株)フェローテックマテリアルテクノロジーズを吸収合併し、事業持株会社になるとともに、社名を(株)フェローテックに変更した。もともとは1980年に米国Ferrofluidics Corporation(現 Ferrotec (USA) Corporation)の日本法人(旧 日本フェローフルイディクス(株))として設立されたが、その後、親会社から分離独立し独自路線を歩んでいる。

現在の主力事業は、真空シール・金属加工、石英製品、セラミックス、CVD-SiC、磁性流体、サーモモジュール、並びにパワー半導体基板など、主に無機材料を用いた様々な製品、装置、部品、及び素材等の製造・販売である。また、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに、各種部品等の洗浄、受託加工、及び組立サービスなどの事業も展開している。そのため、世界的に著名な大手半導体製造装置メーカーが主要な顧客となっている。

#### 2. 沿革

同社は1980年に米国企業の日本法人として設立された。当初は親会社製品である真空シール等の輸入販売が主たる業務であったが、1982年には千葉県に工場を建設し、自社生産を開始した。自社製品比率が高まるにつれて親会社との関係が希薄化したため、1987年には親会社から完全に独立し、独自路線を歩み始めた。その後もHDD用ラミネートシール及び超高真空用フッ素系磁性流体などの自社製品を開発し、1992年には初の中国拠点として杭州市に、1995年には中国で2つ目の製造拠点を上海市に設立した。さらに同年に社名を「株式会社フェローテック」に改称した。

その後も製品群及び事業の拡大を続け、1999年には元の親会社であるFerrofluidics Corporationを友好的TOBにより子会社化した。21世紀に入ってから、2001年に米国Amerigon Incorporated(現 Gentherm Incorporated)と自動車温調システムで業務提携を締結した。2002年には中国上海工場で大口径シリコンウエーハの受託加工を開始し、2005年にはロシアのサーモモジュールメーカーであるSCTB NORD(現 Ferrotec Nord Corporation)を子会社化した。さらに2010年には英国Edwards Vacuum Incから真空蒸着装置事業を取得し、2011年には中国銀川市に大型工場を新設した。2015年にはCVD-SiC製品の製造及び販売を行う(株)アドマップ(現(株)フェローテック)、2016年には産業用クリーニング機器の製造及び販売を行う(株)アサヒ製作所に資本参加して子会社化し、事業の拡大を続けた。2017年4月には持株会社体制へ移行し、現在では日本、欧州、米国、中国、及び東南アジアなど世界9ヶ国に製造子会社及び販売会社を有する国際的な企業となっている。2025年7月1日付で国内事業子会社である(株)フェローテックマテリアルテクノロジーズを吸収合併し、事業持株会社へと移行するとともに、社名を(株)フェローテックに変更した。

株式については、1996年10月に日本証券業協会へ店頭登録を行い、現在は東京証券取引所スタンダード市場に上場している。

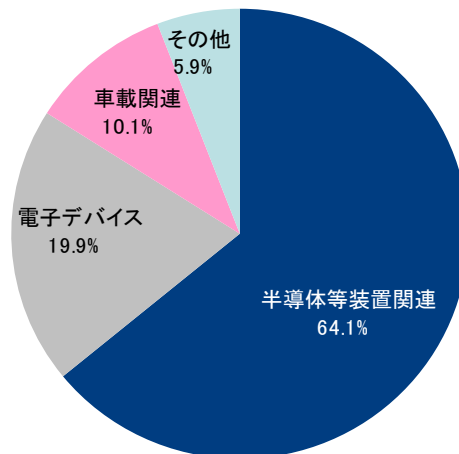
## ■ 事業概要

### 主力は半導体等装置関連事業、電子デバイスや車載用にも展開

#### 1. 事業セグメント

同社は多くの製品を自社開発・製造すると同時にM&Aによって多くの企業を子会社化してきたことから、事業内容は多岐にわたっている。現在のセグメントは半導体等装置関連事業(2026年3月期売上高比率64.1%)、電子デバイス事業(同19.9%)、車載関連事業(同10.1%)、その他事業(同5.9%)に分かれる。

セグメント別売上高比率  
(2026年3月期:288,933百万円)

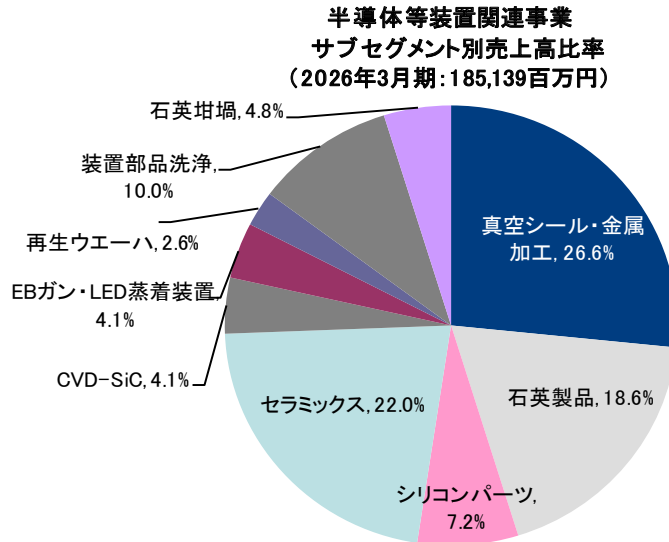


出所：決算説明資料よりフィスコ作成

#### 2. 半導体等装置関連事業

半導体等装置関連事業は、さらに真空シール・金属加工、石英製品、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC、EBガン・LED蒸着装置、ウエーハ加工、再生ウエーハ、装置部品洗浄、石英坩堝のサブセグメントに分かれる。

事業概要



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

#### (1) 真空シール・金属加工

磁性流体を利用して真空雰囲気内への回転導入機としての役割を担う部品で、半導体、FPD、LED、及び太陽電池等の製造工程で広く利用されている。同社の核となる製品であり、主に半導体ウエーハのエッチングや成膜工程、並びにFPDのパネル搬送用ロボットの回転機構部などに導入されており、密閉空間を外部から隔離しつつ、加工に必要な動力を正確に伝えることを可能にしている。

#### (2) 石英製品及びシリコンパーツ

石英製品は熱と化学変化に強い超高純度のシリカガラスからなり、ウエーハの成膜生成や拡散プロセスなどで使われるほか、搬送や洗浄工程で治具、消耗品として使われており、微細化・高純度化が進む半導体製造プロセスのなかで重要な役割を担っている。シリコンパーツ（ポート、インジェクター、フォーカスリング等）は、加工して主に半導体製造工程等で使われる。

#### (3) セラミックス

同社の素材技術、生産技術、精密加工技術を生かして様々なセラミックス製品を提供している。セラミックス製品は高強度、高純度、高耐熱性に優れたファインセラミックス (FC) 製品と、高度な機械加工が可能なマシナブルセラミックス (MC) 製品に大別される。前者は主に半導体製造装置用の部品として使われているが、特にドライエッチング方式（プラズマエッチャー）では不可欠な部品となっている。後者は様々な加工を施すことで各種部品や治具として利用されるが、特に半導体の検査工程における治具（ウエーハプローバ用）として需要が高まっている。また近年では、その精密加工特性を生かして高度な医療用機器での利用も進んでいる。

#### (4) CVD-SiC

独自のCVD方式による炭化ケイ素 (SiC) 製品で、超高純度、高耐熱性、高耐摩耗性、耐腐食性といった特性を備えている。半導体製造工程で用いられるウエーハポートやチューブ、シリコンウエーハの代替となるダミーウエーハなど、主に高温で使用される治具として幅広く活用されている。

## 事業概要

**(5) EBガン・LED蒸着装置**

EB (Electron Beam) ガンとは電子銃のことで、高機能なEBガン及び高圧電源を心臓部とした米国製 Temescal装置 (精密蒸着装置) によって、基板等に薄膜を形成する。同社は、大学や研究所向けの小規模生産用タイプから、大規模生産用高スループットタイプまで幅広い製品群を揃えている。次世代通信などで利用が見込まれる化合物半導体分野での世界標準機として数多くの顧客に使用されており、現在ではLED及び通信チップ製造プロセス等での導入が進んでいる。

**(6) 再生ウエーハ**

ウエーハ加工では、集積回路の基板材料であるシリコンウエーハを製造している。2022年3月期より、中国における半導体国産化の加速に伴う需要の急増を受けて、新たに再生ウエーハ事業を立ち上げた。再生ウエーハとは、設備の確認やテスト等で使用したダミーウエーハの表面を研磨加工することにより、繰り返し使用可能にしたウエーハのことである。半導体の生産量が増加すると、それに伴い再生ウエーハの需要も高まる傾向にある。ただし、同事業を行う子会社は新会社及び新工場設立に伴い増資することにより、2026年7月以降に持分法適用会社となる見込みである。

**(7) 装置部品洗浄**

半導体製造装置用部品の洗浄作業を行う。

**(8) 石英坩堝**

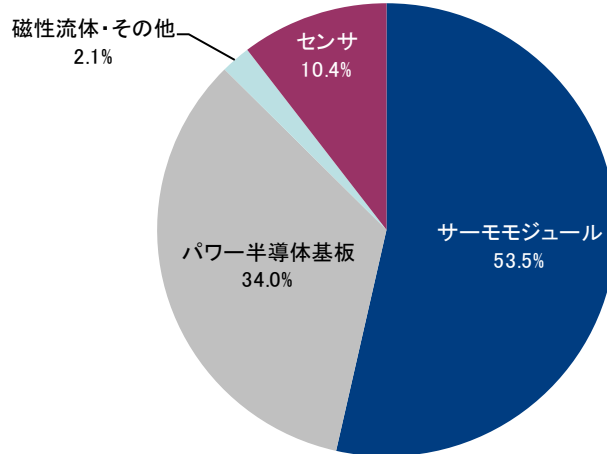
同社の石英坩堝は、半導体製造工程に不可欠な石英製品と同等の高純度原料を使用しており、単結晶シリコンの原料を充填する容器として使用されている。半導体用及び太陽電池用などの単結晶シリコンを製造するメーカーが主な顧客である。ただし、今後は太陽光発電 (PV : Photovoltaic) 向けについては順次縮小する方針である。

**3. 電子デバイス事業**

電子デバイス事業は、サーモモジュール、パワー半導体基板、磁性流体・その他、センサの4つのサブセグメントに分かれる。なお、電子デバイス事業に含まれていた自動車向け製品は、2025年3月期より車載関連事業に切り分けた。

事業概要

電子デバイス事業  
サブセグメント別売上高比率  
(2026年3月期:57,584百万円)



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

(1) サーモモジュール

サーモモジュールは、2種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動するという効果を利用した板状の半導体冷熱素子(ペルチェ素子)である。小型・軽量でフロン要らずといった特長があり、自動車の温調シートをはじめ、冷却チャラー、光通信、パイオ、エアコン、ドライヤーなど様々な家電製品に採用されている。2025年3月期から車載用を車載関連事業に切り分けたため、当サブセグメントに含まれるものは自動車向け以外である。

(2) パワー半導体基板

パワー半導体基板とは、サーモモジュール製造技術を応用して、アルミナや窒化アルミニウムセラミックスに銅回路板を接合した放熱用絶縁基板のことである。同製品は、電車、電動車、エアコン、及びサーバー等の小型化並びに省エネ化に寄与しており、今後の需要拡大が期待される製品である。特に、自動車の電動化(EV化)が進むと、IGBT※などのハイパワー半導体が必要となり、その製造において同社の基板は必須の部品となる。なお、当サブセグメントについても2025年3月期より車載用を車載関連事業に切り分けた。

※ IGBTとは、絶縁ゲート型バイポーラトランジスター (Insulated Gate Bipolar Transistor) の略で、パワートランジスターの一種。

(3) 磁性流体・その他

磁性流体とは液体でありながら、外部磁場によって磁性を帯び、磁石に吸い寄せられる機能性素材である。1960年代のNASA (アメリカ航空宇宙局) によるスペースプログラムにおいて、無重力環境における燃料輸送等の目的で開発された。現在では、スピーカー、アクチュエーター、センサー、及び分別リサイクル用途のほか、同社の主力製品の1つである真空シールにも利用されている。

事業概要

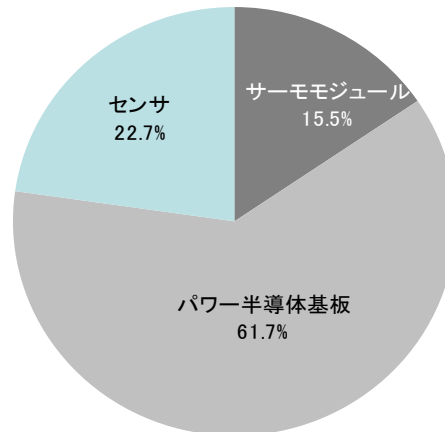
(4) センサ

連結子会社の(株)大泉製作所が製造するサーミスタセンサや関連する部品などが含まれる。なお大泉製作所は決算期変更を行ったため、2025年3月期の連結決算には9ヶ月分だけが含まれている。また、当サブセグメントも自動車向けは2025年3月期から車載関連事業に切り分けた。

4. 車載関連事業

車載関連事業は、それまで電子デバイス事業に含まれていた製品のうち、車載用を切り出したもので、サーモジュール、パワー半導体基板、センサの3つのサブセグメントに分かれる。

車載関連事業  
サブセグメント別売上高比率  
(2026年3月期: 29,245百万円)



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

(1) サーモジュール

主に自動車の温調シートや冷蔵庫用などに使われる。

(2) パワー半導体基板

主にEV自動車向けのAMB (Active Metal Brazing) 基板とDCB (Direct Copper Bonding) 基板を扱う。

(3) センサ

自動車向けの各種センサを扱う。

5. その他

その他には、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品、子会社であるアサヒ製作所のリネン系洗剤、受託作業などがある。太陽電池用シリコン製品事業を縮小する方針であることから売上高は減少傾向にある。

## 各種無機系部品の量産対応力が強み

### 6. 特色、強み

#### (1) 無機系素材のパイオニア

同社は石英、シリコン、窒化ケイ素、及びシリコンカーバイド (SiC) などの幅広い無機系素材の生成並びに加工等に長年携わってきた。そのため、社内にはこれらの素材に関する多くのノウハウ、すなわち素材の性質、生成方法、及び加工方法等が蓄積されており、1社で多数の素材を取り扱えることが同社の特色であり強みと言える。

#### (2) 量産対応力

同社は、上記のように様々な素材や部品を提供しているが、これらの部品類の大量生産に素早く対応できる点も同社の強みである。顧客からのニーズを汲み取り、これに迅速に対応して生産能力を拡大してきた。当然ながらこれにはリスクも伴い、顧客からの発注が予想以上に遅延したりずれ込んだりした場合には、多大な償却負担を負うことになる。現在までのところ同社は積極的にリスクを取って対応してきたが、この姿勢が顧客からの信頼につながっており、このような判断力及び対応力は同社の確固たる強みと言えるだろう。

#### (3) 一貫通貫の対応力と厳しい認証をクリアする供給力

同社は、素材や加工部品、最終製品、及び製造装置など多角的な提案によるソリューションを提供している。また、素材供給から部品加工、装置類の組立から部品洗浄に至るまで一貫通貫の対応が可能である。同社の強みは、こうした製造装置に関するノウハウや幅広い事業展開に加え、大手半導体装置メーカーの厳しい認証を取得していること、そしてその厳しい基準に応じるだけの十分な体力を備えていることである。さらに、これらの認証をクリアしたうえで、顧客の大量生産ニーズに対して安定的に応えられる供給体制を確立していることも、他社にはない大きな優位性となっている。

#### (4) 大手顧客との信頼関係

同社の主要製品は、主に半導体製造装置向け及び半導体製造プロセスで使用されるため、主要顧客には世界トップクラスの半導体製造装置メーカーが多く名を連ねている。同社はこれら大手半導体製造装置メーカーに対して長年にわたり製品や部品を供給し続けており、これら顧客との間に築かれた深い信頼関係も、同社の財産であり強みとなっている。

## 業績動向

### 2026年3月期は主要製品の需要増で14.4%の営業増益

#### 1. 2026年3月期の業績概要

##### (1) 損益状況

2026年3月期の業績は、売上高が前期比5.3%増の288,933百万円、営業利益が同14.4%増の27,561百万円、経常利益が同2.0%増の26,063百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同5.1%減の14,886百万円となった。

セグメント別の売上高は、半導体等装置関連事業が同12.0%増、電子デバイス事業が同14.1%増、車載関連事業が同4.0%減、その他が同39.8%減となった。主力の半導体等装置関連事業が増収となったことなどから、売上総利益率は28.1%（前期26.7%）と前期比で改善した。この結果、売上総利益は81,317百万円（前期比10.8%増）となり、販管費が計画どおり同9.1%増となったことから、営業利益は2ケタ増益を確保した。

営業外費用で為替差損が693百万円発生したこと（前期は1,707百万円の差益）、持分法による投資損失が5,848百万円（同5,420百万円）となったことなどから経常利益の増益幅は小幅にとどまった。さらに法人税等が7,729百万円（前期は5,746百万円）と増加したことから親会社株主に帰属する当期純利益は前期比5.1%減となった。

マレーシア・クリムの新工場を中心に設備投資額は54,598百万円（前期は51,776百万円）、減価償却費は27,426百万円（同23,672百万円）であった。この結果、EBITDA（償却前営業利益）は54,988百万円（前期比15.1%増）となった。

#### 2026年3月期の業績

（単位：百万円）

	25/3期		26/3期		前期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	増減率
売上高	274,390	-	288,933	-	14,542	5.3%
売上総利益	73,361	26.7%	81,317	28.1%	7,955	10.8%
販管費	49,271	18.0%	53,755	18.6%	4,483	9.1%
営業利益	24,089	8.8%	27,561	9.5%	3,471	14.4%
経常利益	25,558	9.3%	26,063	9.0%	505	2.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	15,692	5.7%	14,886	5.2%	-806	-5.1%
設備投資額※	51,776	-	54,598	-	2,822	5.5%
減価償却費	23,672	-	27,426	-	3,754	15.9%

※設備投資額＝有形固定資産及び無形固定資産の取得額の合計  
出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

## 高水準の設備投資で有形固定資産は360億円増、 一方で有利子負債も400億円増加

### (2) 財務状況

2026年3月期末の財務状況は、流動資産が338,977百万円(前期末比43,610百万円増)となった。主に現金及び預金の増加12,191百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加9,102百万円、棚卸資産の増加16,230百万円による。売上増加に伴い売上債権及び棚卸資産が増加した。固定資産は350,260百万円(同45,033百万円増)となった。主に設備投資による有形固定資産の増加36,043百万円、無形固定資産の減少371百万円(主にのれんの減少184百万円、その他の減少186百万円)、投資その他の資産の増加9,361百万円(主に、投資有価証券の増加7,598百万円)であった。その結果、資産合計は689,238百万円(同88,644百万円増)となった。

負債合計は327,162百万円(前期末比50,119百万円増)となった。主に支払手形及び買掛金(電子記録債務含む)の減少637百万円、短期借入金の減少9,032百万円、1年内返済予定の長期借入金(1年内償還予定の社債含む)の増加17,180百万円、社債の増加7,083百万円、長期借入金の増加24,817百万円による。これにより、2026年3月期末の有利子負債は202,344百万円(同40,047百万円増)となった。

純資産合計は362,075百万円(同38,525百万円増)となった。主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加7,394百万円、円安による為替換算調整勘定の増加11,381百万円、その他有価証券評価差額金の増加2,390百万円などによる。この結果、2026年3月期末の自己資本比率は37.6%(前期末39.4%)となり、目標である40%を下回った。

## 業績動向

## 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	25/3期末	26/3期末	増減額
流動資産合計	295,367	338,977	43,610
現金及び預金	117,727	129,918	12,191
受取手形、売掛金及び契約資産	92,608	101,710	9,102
棚卸資産	72,078	88,309	16,230
固定資産合計	305,226	350,260	45,033
有形固定資産	245,064	281,107	36,043
無形固定資産	6,166	5,795	-371
投資その他資産	53,996	63,357	9,361
資産合計	600,593	689,238	88,644
流動負債合計	151,750	163,052	11,301
支払手形及び買掛金(電子記録債務含む)	59,591	58,954	-637
短期借入金	34,482	25,450	-9,032
1年以内返済の長期借入金、1年内償還予定の社債	24,592	41,772	17,180
固定負債合計	125,292	164,110	38,817
社債	0	7,083	7,083
長期借入金	78,222	103,039	24,817
負債合計	277,043	327,162	50,119
純資産合計	323,549	362,075	38,525
利益剰余金	90,435	97,829	7,394
為替換算調整勘定	46,859	58,240	11,381
その他有価証券評価差額金	936	3,326	2,390
有利子負債	162,296	202,344	40,047

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

**(3) キャッシュ・フローの状況**

2026年3月期における営業活動によるキャッシュ・フローは29,255百万円の収入であった。主な収入は税金等調整前当期純利益の計上26,157百万円、減価償却費27,426百万円、持分法による投資損益5,848百万円などで、主な支出は売上債権の増加4,391百万円、棚卸資産の増加14,034百万円、仕入債務の減少3,264百万円などによる。投資活動によるキャッシュ・フローは66,856百万円の支出であった。主に定期預金の増加(ネット)による支出6,392百万円、有形固定資産の取得による支出54,197百万円、投資有価証券の取得による支出1,926百万円による。財務活動によるキャッシュ・フローは38,798百万円の収入であった。主な収入は長短借入金の増加(ネット)32,741百万円、非支配株主からの払込みによる収入15,236百万円で、主な支出は社債の償還320百万円、配当金の支払額7,494百万円であった。

これにより2026年3月期の現金及び現金同等物は前期末比5,061百万円増加し、期末残高は113,960百万円となった。

業績動向

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	25/3期	26/3期
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,066	29,255
投資活動によるキャッシュ・フロー	-39,627	-66,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,965	38,798
現金及び現金同等物の増減額	12,092	5,061
現金及び現金同等物の期末残高	108,899	113,960

出所：決算短信よりフィスコ作成

## 主力の半導体等装置関連事業と電子デバイス事業は増収増益

### 2. セグメント別概況

セグメント別状況を見ると、主力の半導体等装置関連事業は、売上高185,139百万円（前期比12.0%増）、営業利益16,048百万円（同30.4%増）となった。半導体製造装置メーカーの生産増強に伴い、関連する需要が増加したが、そのなかでも特にセラミックス、真空シール、及び金属加工の需要が拡大した。さらに、主に中国における半導体生産の増加に伴って、装置部品の洗浄や再生ウエーハの需要も増加した。

電子デバイスの売上高は57,584百万円（前期比14.1%増）、営業利益は10,465百万円（同26.8%増）となった。好調な生成AIサーバ投資を背景に光トランシーバー向けサーモジュールの売上が拡大した。センサは大泉製作所の決算期変更により、前年度は9ヶ月だけの売上高だったことから前年比で増加した。

車載関連の売上高は29,245百万円（前期比4.0%減）、営業利益は2,694百万円（同25.1%減）となった。EV向け等のパワー半導体基板の需要が調整局面となり売上・利益とも低調に推移した。サーモジュールも苦戦した。センサは大泉製作所の決算期変更により、前期比で増加した。

その他の売上高は16,964百万円（前期比39.8%減）、営業損益は297百万円の損失（前期は843百万円の利益）となった。太陽光関連が低迷していることから、セグメント損失を計上した。

## 業績動向

## セグメント別売上高・営業利益

(単位：百万円)

	25/3期		26/3期		前期比	
	実績	構成比・利益率	実績	構成比・利益率	増減額	増減率
売上高	274,390	-	288,933	-	14,543	5.3%
半導体等装置関連	165,245	60.2%	185,139	64.1%	19,894	12.0%
真空シール・金属加工	39,195	14.3%	49,218	17.0%	10,023	25.6%
石英製品	31,930	11.6%	34,376	11.9%	2,446	7.7%
シリコンパーツ	13,687	5.0%	13,363	4.6%	-324	-2.4%
セラミックス	33,155	12.1%	40,662	14.1%	7,507	22.6%
CVD-SiC	8,192	3.0%	7,588	2.6%	-604	-7.4%
EBガン・LED蒸着装置	8,242	3.0%	7,536	2.6%	-706	-8.6%
再生ウエーハ	2,856	1.0%	4,878	1.7%	2,022	70.8%
装置部品洗浄	15,306	5.6%	18,603	6.4%	3,297	21.5%
石英坩堝	12,668	4.6%	8,909	3.1%	-3,759	-29.7%
電子デバイス	50,487	18.4%	57,584	19.9%	7,097	14.1%
サーモモジュール	27,225	9.9%	30,821	10.7%	3,596	13.2%
パワー半導体基板	18,152	6.6%	19,576	6.8%	1,424	7.8%
磁性流体・その他	1,137	0.4%	1,205	0.4%	68	6.0%
センサ	3,971	1.4%	5,980	2.1%	2,009	50.6%
車載関連	30,463	11.1%	29,245	10.1%	-1,218	-4.0%
サーモモジュール	6,412	2.3%	4,535	1.6%	-1,877	-29.3%
パワー半導体基板	19,250	7.0%	18,057	6.2%	-1,193	-6.2%
センサ	4,801	1.7%	6,653	2.3%	1,852	38.6%
その他	28,194	10.3%	16,964	5.9%	-11,230	-39.8%
営業利益	24,089	8.8%	27,561	9.5%	3,472	14.4%
半導体等装置関連	12,305	-	16,048	-	3,743	30.4%
電子デバイス	8,250	-	10,465	-	2,215	26.8%
車載関連	3,599	-	2,694	-	-905	-25.1%
その他	843	-	-297	-	-1,140	-
調整額	-909	-	-1,349	-	-	-

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

主要なサブセグメントの状況は以下のとおりである。

**(1) 真空シール・金属加工、ウエーハ加工、再生ウエーハ**

真空シール・金属加工の売上高は、半導体装置関連の需要の拡大により49,218百万円(前期比25.6%増)となった。

ウエーハ加工は、主体となる子会社が持分法適用子会社となったことから売上計上はなくなった。再生ウエーハの売上高は4,878百万円(同70.8%増)となり、堅調に推移している。

業績動向

**(2) 半導体材料、石英製品、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-Sic、装置部品洗浄、石英坩堝**

石英製品は、中国の顧客や火加工需要を取込み、売上高は34,376百万円(前期比7.7%増)となった。シリコンパーツは、顧客の在庫調整により売上高は13,363百万円(同2.4%減)にとどまった。セラミックスは、米国メーカー向け需要が堅調だったことに加えて中国での需要も増加し、売上高は40,662百万円(同22.6%増)となった。CVD-Sicは、需要が低迷し売上高は7,588百万円(同7.4%減)となった。

装置部品洗浄では、中国顧客の需要を取り込み売上高は18,603百万円(前期比21.5%増)となった。一方で石英坩堝は、太陽光発電向けの需要がさらに減少して売上高は8,909百万円(同29.7%減)となった。

**(3) サーモモジュール**

電子デバイスの中のサーモモジュールは、好調な生成AIサーバ投資を背景に光トランシーバー向けサーモモジュールの売上が拡大し売上高は30,821百万円(前期比13.2%増)となった。車載関連では、中国EV車向けが低迷して売上高は4,535百万円(同29.3%減)となった。

**(4) パワー半導体基板、センサ**

電子デバイスの中のパワー半導体基板は、産業機械向け(主にDCB基板)が堅調に推移して売上高は19,576百万円(前期比7.8%増)となった。車載関連のパワー半導体基板(主にAMB基板)もEV車市場の低迷の影響を受けて売上高は18,057百万円(同6.2%減)と低迷した。

センサでは、電子デバイスは5,980百万円(前期比50.6%増)、車載関連は6,653百万円(同38.6%増)といずれも堅調であったが、これは主に大泉製作所の決算期変更(9ヶ月決算)による。

**3. 主な投資と減価償却費**

2026年3月期の設備投資額は54,598百万円(前期は51,776百万円)となった。主な投資は、欧米顧客の中国外生産(Ex-China)ニーズに対応したマレーシア・クリム第1工場(石英、セラミックス、金属加工)、同第2工場(石英、セラミックス、金属加工)などである。減価償却費は27,426百万円(前期は23,672百万円)と大幅に増加した。

## ■ 今後の見通し

### 2026年12月期の営業利益は前期比37.9%増を予想。 主要顧客からの需要拡大が続く

**1. 2026年12月期の業績見通し**

同社は2026年12月期より決算期を3月から12月に変更した。連結子会社は従来どおり12ヶ月決算(1~12月)のため、同社単体が9ヶ月決算(4~12月)となることによる連結業績への影響は限定的である。

**フェローテック** | 2026年7月7日 (火)  
 6890 東証スタンダード市場 | <https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

今後の見通し

2026年12月期の業績は、売上高350,000百万円(2026年3月期比21.1%増)、営業利益38,000百万円(同37.9%増)、経常利益36,000百万円(同38.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益23,000百万円(同54.5%増)を見込んでいる。

生成AIやデータセンター向け需要を中心に世界的に半導体市場が活況を呈している状況で、主力の半導体等装置関連事業の売上高は同20.0%増を見込んでいる。また、AI関連向けサーモモジュールがけん引して電子デバイス事業も同28.4%増の予想。車載関連事業は、EV向けの回復を見込みパワー半導体基板やセンサが増加することから同23.6%増を予想している。その他も底打ちが見られることから4.4%増を見込んでいる。

その結果、増収により高水準の減価償却費を吸収する見込みであり、営業利益は大幅な増益予想となっている。設備投資額は65,000百万円(2026年3月期比19.1%増)、減価償却費は32,172百万円(同17.3%増)と増加を見込んでいる。

**2026年12月期の業績見通し**

(単位：百万円)

	26/3期		26/12期		2026年3月期比	
	実績	構成比・利益率	予想	構成比・利益率	増減額	増減率
売上高	288,933	-	350,000	-	61,067	21.1%
半導体等装置関連	185,139	64.1%	222,190	63.5%	37,051	20.0%
真空シール・金属加工	49,218	17.0%	68,307	19.5%	19,089	38.8%
石英製品	34,376	11.9%	38,912	11.1%	4,536	13.2%
シリコンパーツ	13,363	4.6%	17,198	4.9%	3,835	28.7%
セラミックス	40,662	14.1%	49,036	14.0%	8,374	20.6%
CVD-SiC	7,588	2.6%	4,416	1.3%	-3,172	-41.8%
EBガン・LED蒸着装置	7,536	2.6%	7,059	2.0%	-477	-6.3%
再生ウエーハ	4,878	1.7%	2,943	0.8%	-1,935	-39.7%
装置部品洗浄	18,603	6.4%	22,848	6.5%	4,245	22.8%
石英坩堝	8,909	3.1%	11,471	3.3%	2,562	28.7%
電子デバイス	57,584	19.9%	73,965	21.1%	16,381	28.4%
サーモモジュール	30,821	10.7%	40,526	11.6%	9,705	31.5%
パワー半導体基板	19,576	6.8%	22,511	6.4%	2,935	15.0%
磁性流体・その他	1,205	0.4%	1,534	0.4%	329	27.2%
センサ	5,980	2.1%	9,394	2.7%	3,414	57.1%
車載関連	29,245	10.1%	36,135	10.3%	6,890	23.6%
サーモモジュール	4,535	1.6%	5,846	1.7%	1,311	28.9%
パワー半導体基板	18,057	6.2%	22,247	6.4%	4,190	23.2%
センサ	6,653	2.3%	8,042	2.3%	1,389	20.9%
その他	16,964	5.9%	17,710	5.1%	746	4.4%
営業利益	27,561	9.5%	38,000	10.9%	10,439	37.9%
経常利益	26,063	9.0%	36,000	10.3%	9,937	38.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	14,886	5.2%	23,000	6.6%	8,114	54.5%
設備投資額	54,598	-	65,000	-	10,402	-
減価償却費	27,426	-	32,172	-	4,746	-

出所：決算説明資料よりフィスコ作成

## 2. サブセグメント別見通し

主要なサブセグメント別売上高の予想は以下のとおりである。

### (1) 真空シール・金属加工、ウエーハ加工、再生ウエーハ

半導体製造装置向け金属加工、装置組み立てが増加見通しであることから、真空シール・金属加工の売上高は68,307百万円(2026年3月期比38.8%増)と予想している。

ウエーハ加工は縮小傾向にあるため、売上高はゼロとなる予想である。一方で、再生ウエーハは2026年7月以降は非連結化し、連結売上を計上しない予定であることからこの期の売上高は2,943百万円(2026年3月期比39.7%減)と予想している。半期分の売上計上となる。

### (2) 半導体マテリアル、装置部品洗浄、石英坩堝

石英製品の売上高は半導体製造に連動する消耗材であり、顧客在庫の影響を受けるが今期は38,912百万円(2026年3月期比13.2%増)を予想。シリコンパーツも装置メーカーからの引き合いが増加しており売上高は17,198百万円(同28.7%増)を見込む。

セラミックスは、半導体製造装置の生産に連動することから売上高は49,036百万円(同20.6%増)を見込む。CVD-SiCの売上高は、需要が弱含みであることに加えて岡山工場分は決算期変更に伴い9ヶ月分のみ計上となるため売上高は4,416百万円(同41.8%減)を見込む。

装置部品洗浄は、中国における半導体生産に連動することから需要は堅調であり売上高は22,848百万円(同22.8%増)を見込む。石英坩堝は、採算が悪化した太陽光発電向けが縮小し、半導体向け中心にシフトすることから、売上高は11,471百万円(同28.7%増)と回復を見込んでいる。

### (3) サーモモジュール

電子デバイスのサーモモジュールは、AI関連の光トランシーバー向け需要が継続することから、売上高は40,526百万円(2026年3月期比31.5%増)を見込む。車載関連は、自動車向け製品の引合いが増加しており、売上高は5,846百万円(同28.9%増)の予想としている。

### (4) パワー半導体基板、センサ

電子デバイスのパワー半導体基板は、中期的な成長は続く見込みであり製品レンジ拡大により売上増を見込み、売上高は22,511百万円(2026年3月期比15.0%増)を見込む。一方で車載関連のパワー半導体基板(主にDCB基板及びAMB基板)も、中国EV生産が回復見込みであることから売上高は22,247百万円(同23.2%増)を見込む。

センサは、電子デバイス、車載関連ともに需要が回復する見込みであることに加えて決算期変更の影響(前期は9ヶ月分のみ)により、電子デバイスが9,394百万円(2026年3月期比57.1%増)、車載関連が8,042百万円(同20.9%増)を予想している。

### 3. 投資額と減価償却費の見通し

設備投資額は65,000百万円と増加予想で、主な投資対象はマレーシア・クリム第2工場(石英・セラミックス・金属加工)、中国・北京(洗浄・金属加工・セラミックス)、中国・紹興(部品洗浄・パワー半導体基板)、中国・武漢(部品洗浄)などとなっている。

減価償却費は32,172百万円(2026年3月期比17.3%増)を見込んでおり、これによりEBITDAは70,172百万円(同27.6%増)の見込みである。

## ■ 中長期の成長戦略

### 2028年12月期に営業利益57,000百万円、ROE11.0%を目指す

#### 1. 中期経営計画の基本方針

同社では、2028年12月期を最終年度とする中期経営計画を発表したが、足元の半導体業界の動向等を踏まえてこの計画を見直し、目標数値を上方修正した。ただし、定性的な目標や戦略は変わっておらず、以下に示す4つの基本方針を推進する。

##### (1) 事業成長

- ・半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求する。
- ・米中摩擦による中国外製造(Ex-China)のニーズに対応してマレーシア等の中国外製造を強化しながら、中国における半導体関連ニーズの取込みを進める。

##### (2) 収益性向上・生産効率向上

- ・マレーシア(クリム、ジョホール)工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引上げを実現する。
- ・デジタル化・自動化・AI化を展開し、生産効率向上・競争力強化を追求する。
- ・新製品・新技術の開発を推進・強化し、「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続する。

##### (3) 人材強化・企業文化

- ・人材重視を重要な経営戦略とし、人材の採用及び育成を推進する。
- ・企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続する。

##### (4) 財務・株主還元

- ・中国上場の洗浄事業子会社FTSVAとパワー半導体基板子会社FLHの統合実現後には株式時価が増加見通しであり、活用方法を検討する。
- ・新たな株主還元方針に則り、DOE(株主資本配当率)を採用し、自社株式の取得も機動的に検討する方針である。

中長期の成長戦略

## 2. 定量的目標 (KPI)

### (1) 利益計画

2028年12月期までの3年間の売上高、営業利益、利益率等の目標は以下のようになっており、最終年度である2028年12月期には450,000百万円、営業利益57,000百万円(営業利益率12.7%)、ROE11.0%、ROIC7.0%、自己資本比率40%の維持を目指す。

#### 中期経営計画KPI

(単位：百万円)

	2026年3月期 実績	2026年12月期 予想	2027年12月期 計画	2028年12月期 計画
売上高	288,933	350,000	400,000	450,000
営業利益	27,561	38,000	48,000	57,000
(営業利益率)	9.5%	10.9%	12.0%	12.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	14,886	23,000	30,000	38,000
ROE	6.0%	→		11.0%
ROIC※1	3.2%	→		7.0%
自己資本比率	37.6%	40.0%	40.0%	40.0%
設備投資額	54,598	65,000	55,000	40,000
1株当たり年間配当金 (円)	148.0	200.0	DOE (連結株主資本配当率※2) を採用し、 下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、 総還元性向50%を目指す	

注：ROEとROICは当初目標から引き下げられたが、最終的にはそれぞれ15%、8%を目指す

※1：ROIC=親会社株主に帰属する当期純利益÷(有利子負債+純資産)、純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

※2：連結株主資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式、連結株主資本配当率=配当金総額÷連結株主資本

出所：決算説明資料よりフィスコ作成

### (2) 投資計画及びキャッシュ・フロー見通し

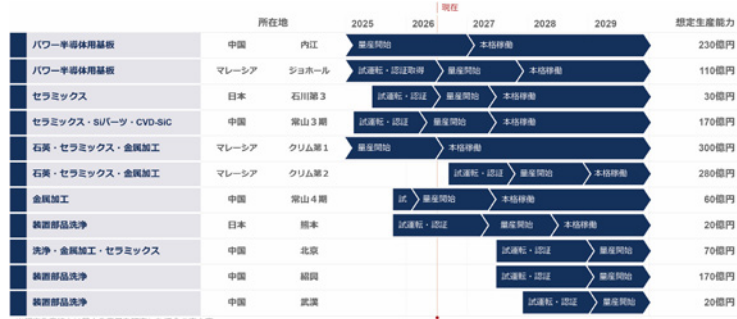
今後3年間の設備投資は累計1,600億円を計画している。主な投資内容は、半導体関連顧客からの2025年以降のキャパシティ増強の要請に対応するための能力増強投資である。また、米中間の貿易摩擦等を考慮し、中国外における生産体制をさらに強化する。さらに、パワー半導体基板等の自動車セグメントへの投資も継続する。この間においては営業キャッシュ・フローの増加により、フリーキャッシュ・フローは改善する見通しである。

## 3. 主な工場新設・生産能力増強の状況

成長へ向けて、工場の新設・増設を着々と進め、生産能力を拡大中である。

中長期の成長戦略

主な工場新設・生産能力増強の状況



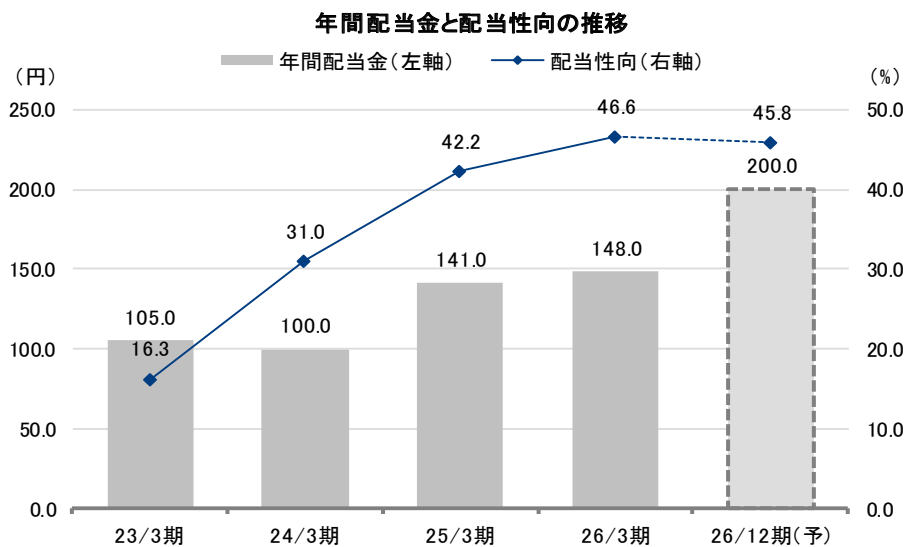
※想定生産能力は最大生産量を超過した場合の売上高  
出所：決算説明資料より掲載

## 株主還元策

### 2026年12月期は年間200円配当を予定

同社は株主還元策として配当を実施している。株主還元の強化を図るため、新たにDOEを採用し、その下限を3.5%に設定した。持続的な収益増強により配当水準の引上げを目指すとともに、財務の状況等を考慮しながら自己株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指して充実を図る方針である。

この方針に沿って2026年3月期は年間148.0円(配当性向46.6%)の配当を行ったが、進行中の2026年12月期も年間200.0円(予想配当性向45.8%)の配当を予定している。高水準の設備投資を継続しながらも、着実に増配を行っている点は評価できる。今後の配当政策及びその推移にも注目したい。



出所：決算短信よりフィスコ作成

本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みください。  
Important disclosures and disclaimers appear at the back of this document.

#### 重要事項 (ディスクレマー)

株式会社フィスコ(以下「フィスコ」という)は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したものです。フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受け、企業から報酬を受け取って作成されています。本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかなを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは強く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

#### ■お問い合わせ■

〒107-0062東京都港区南青山5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443 (IRコンサルティング事業本部)

メールアドレス：support@fisco.co.jp